

2013年11月28日

各 位

会 社 名 パナソニック株式会社  
代表者名 取締役社長 津賀 一宏  
(コード番号 6752 東証・名証第一部)  
問合せ先 財務・IRグループ  
グループマネージャー 若林 勇人  
(TEL. 06-6908-1121)

## 回路基板事業の縮小について

当社は、本日開催の取締役会において、回路基板事業のうち、樹脂多層基板および薄型・高密度配線板事業を終息することを決議し、回路基板事業については縮小することになりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 回路基板事業の縮小について

当社は、1960年に片面プリント配線板の生産を開始し、1996年には樹脂多層基板(以下、「ALIVH」※<sup>1</sup>)の生産を開始しました。以降、多層化技術に対する評価をいただき、ALIVHは、国内携帯電話市場においても高いシェアを確保してまいりました。また当社は2012年に、三洋電機株式会社(以下、「三洋電機」)が行う薄型・高密度配線板(以下、「ISB」※<sup>2</sup>)事業との一体運営を開始し、回路基板事業を展開してまいりました。

その後、競争激化など経営環境の変化を受け、当社は当該事業について、事業構造転換を含む様々な方策を検討してまいりました。今般、事業の継続が困難であるとの判断の下、ALIVH事業およびISB事業を終息し、回路基板事業を縮小いたします。

当該決定により、2013年度末から2014年度中を目処として、国内では三重県松阪市(ALIVH事業)および群馬県邑楽郡大泉町(ISB事業)の各拠点における生産を終了します。なお、ベトナム、台湾の海外2拠点のこれら事業についても2014年度中に生産を終了する予定です。

※1. ALIVH: Any Layer Interstitial Via Hole。当社が開発・事業化した全層IVH(Interstitial Via Hole)構造の樹脂多層基板。

※2. ISB: Integrated System in Board。三洋電機が開発・事業化したファインパターン形成による主に半導体パッケージ向けの薄型・高密度配線板。

## 2. 今後の見通し

回路基板事業の縮小による連結業績影響については、現在精査中ではありますが、本件による当社の2014年3月期連結業績予想への重要な影響はない見込みです。

以上

(ご参考)

<ALIVH および ISB の生産を終了する拠点>

※各拠点では ALIVH および ISB 以外の事業も営んでおり、拠点閉鎖はありません。

### 【松阪拠点】

拠点名 : パナソニック株式会社  
オートモーティブ&インダストリアルシステムズ社 松阪工場  
所在地 : 三重県松阪市上川町 2460 番地 1 号  
操業開始 : 1970 年 4 月 (ALIVH:1997 年 10 月)  
事業内容 : 機構部品、回路基板(ALIVH)の開発・製造・販売

### 【群馬拠点】

拠点名 : 三洋電機株式会社 東京製作所  
所在地 : 群馬県邑楽郡大泉町坂田 1 丁目 1 番 1 号  
操業開始 : 1959 年 7 月 (ISB:2005 年 12 月)  
事業内容 : 業務用冷凍庫、ショーケース、大型空調、回路基板(ISB)等の開発・製造・販売

### 【ベトナム拠点】

拠点名 : パナソニック デバイス ベトナム有限会社  
所在地 : ハノイ市  
操業開始 : 2006 年 4 月 (ALIVH:2012 年 10 月)  
事業内容 : 機構部品、回路基板(ALIVH、ISB)の製造・販売

### 【台湾拠点】

拠点名 : パナソニック台湾株式会社  
所在地 : 新北市  
操業開始 : 1962 年 10 月 (ALIVH:2005 年 4 月)  
事業内容 : アプライアンス事業、AVC 事業、カーエレ事業、部品事業の開発・製造・販売